



【1000～1200万円】 【MLCC】中堅材料エンジニア ～急拡大中の中華系電子部品企業～

信維通信日本株式会社での募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

信維通信日本株式会社

求人ID

1468739

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

大阪府

給与

1000万円～1200万円

勤務時間

08:30～22:00

休日・休暇

【有給休暇】（有給休暇補足）入社後5日付与、半年経過後10日付与、以降毎年付与最大20日【休日】完全週休二日制 土日祝...

更新日

2024年06月21日 02:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2192159】

【セラミック電子部品 研究開発エンジニア/新拠点の立ち上げメンバー】

《中国に本社を構える世界的な電子部品メーカーの日本法人》

新たな開発拠点設立に伴い、コアメンバーを募集しています。あなたの技術力を活かして、当社の事業を支えてくださいま

せんか？

■仕事内容

【職務詳細】

1. 日本の研究機関の技術上陸を引き受け、新製品の設計と開発、主要プロセスの研究開発に参加し、新製品開発に関連する作業指標を完成する。
2. 技術要件と製品の策定に参加する。
3. 対応する技術改善とプロセスの研究開発を実施し、主要プロセスの開発を実行する。
4. 製品の異常改善を実施し、製品の進捗状況をフォローアップし、テストデータを収集する。
5. その他会社による業務依頼を積極的に完成する。

■同社について

同社は中国の深・に拠点を置く、ハイテク技術企業の一員でございます。

以下は事業内容でございます。

メインとしてはRF関連電子部品及びモジュールの生産、例えば：アンテナと関連モジュール、無線充電モジュール、EMC/EMI RF遮蔽部品、精密コネクタ、高速コネクタ及びケーブル、抵抗やコンデンサとインピーダンスなど及びその他の事業を展開しております。

製品の応用範囲は消費電子類（スマートフォン、pc、ウェアラブルスマートデバイスなど）、自動車類、IOT/スマートホーム類、通信類、データ中心領域類、新世代の情報産業技術分野でございます。

本年度は、関西にセラミック電子部品（主にMLCC）の研究開発拠点の設立を進めています。

研究所の設立に伴い、設備の立ち上げや新規・材料プロセス開発等、研究開発活動の最前線で活躍できる、技術エンジニアを募集しています。

MLCCの技術開発は無機材料、有機材料、塗料設計、設備設計、熱処理技術設計、メッキ技術、情報処理やシミュレーション技術など多岐に渡ります、このため、専門にMLCCをやっておられなくても関連する技術分野があれば、業務遂行は可能です。

本研究所では、従来業界にはない発想でセラミック電子部品の設計開発を志向しているため、他分野の技術者の参加も歓迎いたします。

スキル・資格

■専攻 材料、化学、電子工学、機械工学等、学士以上 ■言語 日本語必須（英語初級以上が望ましい） ■スキル応募資格 MLCCプロセスの基礎研究、製品開発または材料研究に5年以上従事した経験 または 大手MLCCメーカーでの勤務経験 具体的には MLCC製品開発の経験 MLCC製造プロセスに精通している CADソフトウェアおよびオフィスソフトウェアアプリケーションに精通している 最先端の製品、最先端の材料特性および応用研究に精通している 強い論理的思考 コミュニケーションおよび調整スキル プレッシャーに耐える優れた能力 率先して取り組む能力 IATF16949 システムの要件を理解する能力 など

会社説明

電子部品の設計・製造・販売